

各位

株式会社 JCU

代表取締役会長兼CEO 小澤 恵二

パターン埋め込み型基板（ETS）向け配線の寸法変化をなくすエッチング薬品 MSAP基板との一括処理可能、スマホなどの小型・高密度化に貢献

株式会社 JCU（代表取締役会長兼CEO：小澤恵二）は、微細配線を必要とする半導体パッケージ基板に用いられるパターン埋め込み型基板（ETS：Embedded Trace Substrate）に適したエッチング薬品を開発しました。エッチング薬品は基板製造において、めっき法による銅配線（回路）形成処理を施した後、不要な下地の銅部分を剥がす（溶かす）工程で使用します（図1）。従来のエッチング薬品では、配線の寸法に変化が生じるサイドエッチングと呼ばれる問題がありましたが、適切な添加剤を選定することでこれを解決することに成功しました（図2）。この薬品は、微細配線形成に有利なモディファイドセミアディティブプロセス（MSAP：Modified Semi-Additive Process）基板にも適用でき、ETSおよびMSAP基板が混在した基板を一括で適切な形状に処理することが可能になります。これにより、スマートフォンをはじめとする電子機器の一層の小型・薄型・高密度化に貢献してまいります。

このエッチング薬品は、日本、中国、台湾、韓国中心に拡販を予定しています。当初の売り上げ見込みは年2億円。MSAP基板との一括処理を望むユーザー動向次第で、売り上げが膨らむとみています。

ETSは、コア層のないコアレス構造により基板を薄型化できるうえ、銅配線が樹脂基板中に埋め込まれるため寸法変化の少ない高精度な配線形成が可能であることから、近年注目を集めている基板です。当社はCSV（共通価値の創造）、SDGs（持続可能な開発目標）への貢献を見据えながら、主力製品である硫酸銅めっき薬品に加え、半導体パッケージ基板、プリント基板製造に欠かすことのできない表面処理薬品のラインナップを強化してまいります。

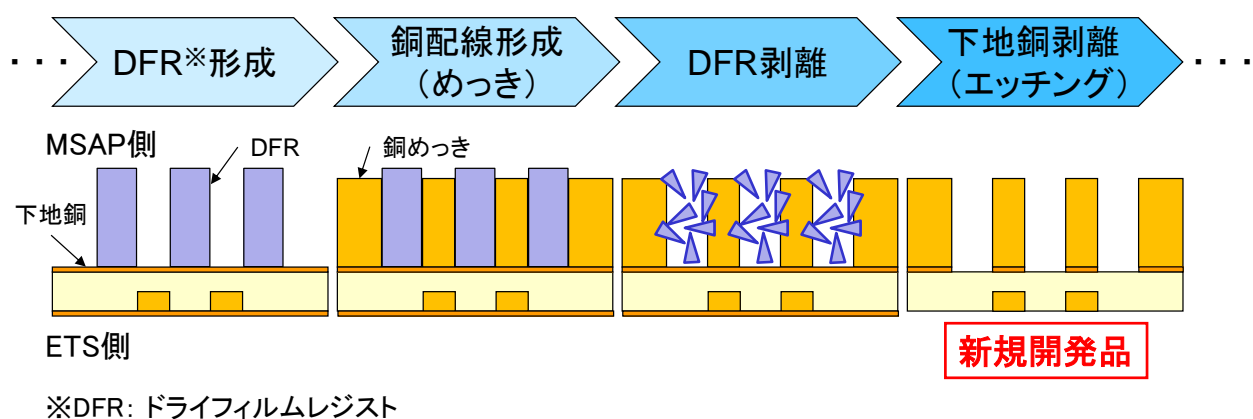


図1 半導体パッケージ基板製造における配線形成フローの一部

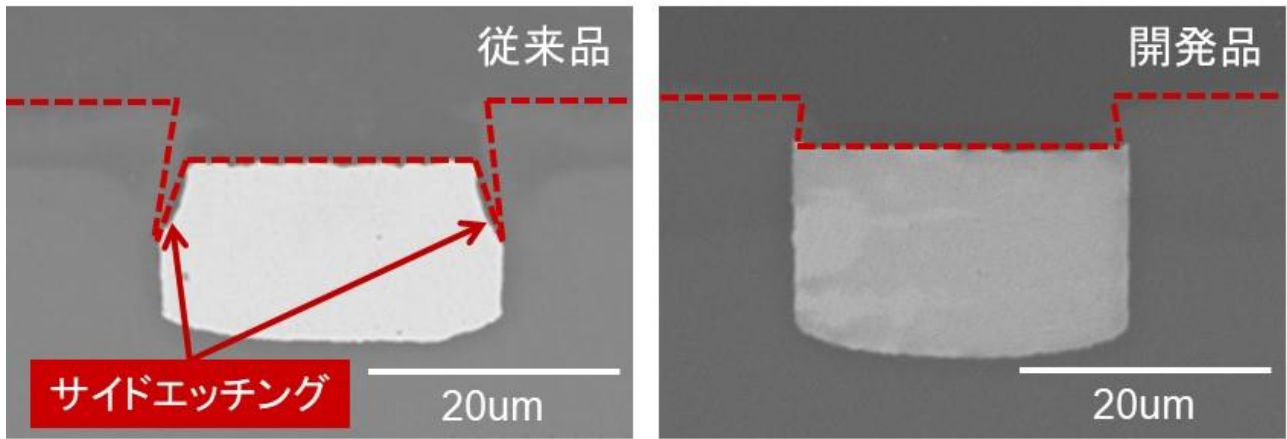


図2 エッチング性能評価結果

SDGs（持続可能な開発目標）



【本件の問い合わせ先】

株式会社 JCU 経営戦略室 広報・IR 課 橋本康男

TEL : 03-6895-7004 FAX : 03-6895-7022 E-mail : kikaku@jcu-i.com

以上